

江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

公司代码: 688300

公司简称: 联瑞新材

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

- 2. 重大风险提示
3. 公司可能面临的风险已在本报告“第二节 管理层讨论与分析”中详细阐述, 敬请投资者查阅。
4. 本公司董事会、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
5. 公司上市以来未发生实现盈利。
6. 公司董事会审议通过的本报告期利润分配预案为: 以 2025 年年度利润分配方案为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税), 拟派发现金红利总额为人民币 120,734,596.00 元(含税), 占 2025 年年度末归属于上市公司普通股股东的净利润 41.28%, 公司本年度未发生现金分红, 不转赠股本, 上述 2025 年年度利润分配方案已于 2026 年年度报告披露(公司总股本 241,460,190 股)。

- 7. 2025 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 尚需经公司 2026 年年度股东大会审议通过后方可实施。
8. 母公司存在外币币种
9. 适用 V 不适用
10. 适用 V 不适用
11. 适用 V 不适用

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 联瑞新材, 688300

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍. 李俊安, 董事长, 男, 中国

1. 公司简介
2. 主要业务
3. 服务网络
4. 主要经营模式
5. 主要客户
6. 主要供应商
7. 主要风险

1.1 行业分析
1.1.1 半导体封装材料行业
1.1.2 先进封装材料行业
1.1.3 导热材料行业
1.1.4 封装材料行业

1.2 行业分析
1.2.1 行业分析
1.2.2 行业分析
1.2.3 行业分析

1.3 行业分析
1.3.1 行业分析
1.3.2 行业分析
1.3.3 行业分析

1.4 行业分析
1.4.1 行业分析
1.4.2 行业分析
1.4.3 行业分析

1.5 行业分析
1.5.1 行业分析
1.5.2 行业分析
1.5.3 行业分析

1.6 行业分析
1.6.1 行业分析
1.6.2 行业分析
1.6.3 行业分析

1.7 行业分析
1.7.1 行业分析
1.7.2 行业分析
1.7.3 行业分析

1.8 行业分析
1.8.1 行业分析
1.8.2 行业分析
1.8.3 行业分析

1.9 行业分析
1.9.1 行业分析
1.9.2 行业分析
1.9.3 行业分析

1.10 行业分析
1.10.1 行业分析
1.10.2 行业分析
1.10.3 行业分析

1.11 行业分析
1.11.1 行业分析
1.11.2 行业分析
1.11.3 行业分析

1.12 行业分析
1.12.1 行业分析
1.12.2 行业分析
1.12.3 行业分析

1.13 行业分析
1.13.1 行业分析
1.13.2 行业分析
1.13.3 行业分析

1.14 行业分析
1.14.1 行业分析
1.14.2 行业分析
1.14.3 行业分析

1.15 行业分析
1.15.1 行业分析
1.15.2 行业分析
1.15.3 行业分析

1.16 行业分析
1.16.1 行业分析
1.16.2 行业分析
1.16.3 行业分析

1.17 行业分析
1.17.1 行业分析
1.17.2 行业分析
1.17.3 行业分析

1.18 行业分析
1.18.1 行业分析
1.18.2 行业分析
1.18.3 行业分析

3.2 报告期末的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 公司简介
5. 主要业务
6. 主要客户
7. 主要供应商
8. 主要风险

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 联瑞新材, 688300

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 国籍. 李俊安, 董事长, 男, 中国

1. 公司简介
2. 主要业务
3. 服务网络
4. 主要经营模式
5. 主要客户
6. 主要供应商
7. 主要风险

1.1 行业分析
1.1.1 半导体封装材料行业
1.1.2 先进封装材料行业
1.1.3 导热材料行业
1.1.4 封装材料行业

1.2 行业分析
1.2.1 行业分析
1.2.2 行业分析
1.2.3 行业分析

1.3 行业分析
1.3.1 行业分析
1.3.2 行业分析
1.3.3 行业分析

1.4 行业分析
1.4.1 行业分析
1.4.2 行业分析
1.4.3 行业分析

1.5 行业分析
1.5.1 行业分析
1.5.2 行业分析
1.5.3 行业分析

1.6 行业分析
1.6.1 行业分析
1.6.2 行业分析
1.6.3 行业分析

1.7 行业分析
1.7.1 行业分析
1.7.2 行业分析
1.7.3 行业分析

1.8 行业分析
1.8.1 行业分析
1.8.2 行业分析
1.8.3 行业分析

1.9 行业分析
1.9.1 行业分析
1.9.2 行业分析
1.9.3 行业分析

1.10 行业分析
1.10.1 行业分析
1.10.2 行业分析
1.10.3 行业分析

1.11 行业分析
1.11.1 行业分析
1.11.2 行业分析
1.11.3 行业分析

1.12 行业分析
1.12.1 行业分析
1.12.2 行业分析
1.12.3 行业分析

1.13 行业分析
1.13.1 行业分析
1.13.2 行业分析
1.13.3 行业分析

1.14 行业分析
1.14.1 行业分析
1.14.2 行业分析
1.14.3 行业分析

1.15 行业分析
1.15.1 行业分析
1.15.2 行业分析
1.15.3 行业分析

1.16 行业分析
1.16.1 行业分析
1.16.2 行业分析
1.16.3 行业分析

1.17 行业分析
1.17.1 行业分析
1.17.2 行业分析
1.17.3 行业分析

1.18 行业分析
1.18.1 行业分析
1.18.2 行业分析
1.18.3 行业分析

消费电子产品日益增长的需求, 组织效能提升, 为深化产业链并开发人才动能, 公司着力构建战略协同与人力资源协同以支撑体系效能, 同时针对技术、研发、生产、设备等关键岗位开展人才盘点, 高效运营人力资源, 提升人才效能, 促进人才与岗位匹配, 提升人才效能, 在此基础上, 深化数字化应用, 推动产线一体化建设, 建立基于工业 4.0 的智能化制造, 实现业务数据与财务数据高效联动, 从提升效率、降低运营成本, 有力支撑公司战略目标的高质量发展。

2. 高级管理人员、研发创新等
3. 研发投入
4. 研发投入
5. 研发投入
6. 研发投入
7. 研发投入
8. 研发投入
9. 研发投入
10. 研发投入

1. 公司简介
2. 主要业务
3. 服务网络
4. 主要经营模式
5. 主要客户
6. 主要供应商
7. 主要风险

1.1 行业分析
1.1.1 半导体封装材料行业
1.1.2 先进封装材料行业
1.1.3 导热材料行业
1.1.4 封装材料行业

1.2 行业分析
1.2.1 行业分析
1.2.2 行业分析
1.2.3 行业分析

1.3 行业分析
1.3.1 行业分析
1.3.2 行业分析
1.3.3 行业分析

1.4 行业分析
1.4.1 行业分析
1.4.2 行业分析
1.4.3 行业分析

1.5 行业分析
1.5.1 行业分析
1.5.2 行业分析
1.5.3 行业分析

1.6 行业分析
1.6.1 行业分析
1.6.2 行业分析
1.6.3 行业分析

1.7 行业分析
1.7.1 行业分析
1.7.2 行业分析
1.7.3 行业分析

1.8 行业分析
1.8.1 行业分析
1.8.2 行业分析
1.8.3 行业分析

1.9 行业分析
1.9.1 行业分析
1.9.2 行业分析
1.9.3 行业分析

1.10 行业分析
1.10.1 行业分析
1.10.2 行业分析
1.10.3 行业分析

1.11 行业分析
1.11.1 行业分析
1.11.2 行业分析
1.11.3 行业分析

1.12 行业分析
1.12.1 行业分析
1.12.2 行业分析
1.12.3 行业分析

1.13 行业分析
1.13.1 行业分析
1.13.2 行业分析
1.13.3 行业分析

1.14 行业分析
1.14.1 行业分析
1.14.2 行业分析
1.14.3 行业分析

1.15 行业分析
1.15.1 行业分析
1.15.2 行业分析
1.15.3 行业分析

1.16 行业分析
1.16.1 行业分析
1.16.2 行业分析
1.16.3 行业分析

1.17 行业分析
1.17.1 行业分析
1.17.2 行业分析
1.17.3 行业分析

1.18 行业分析
1.18.1 行业分析
1.18.2 行业分析
1.18.3 行业分析

1.19 行业分析
1.19.1 行业分析
1.19.2 行业分析
1.19.3 行业分析

1.20 行业分析
1.20.1 行业分析
1.20.2 行业分析
1.20.3 行业分析

1.21 行业分析
1.21.1 行业分析
1.21.2 行业分析
1.21.3 行业分析

1.22 行业分析
1.22.1 行业分析
1.22.2 行业分析
1.22.3 行业分析

1.23 行业分析
1.23.1 行业分析
1.23.2 行业分析
1.23.3 行业分析

1.24 行业分析
1.24.1 行业分析
1.24.2 行业分析
1.24.3 行业分析

的合规性, 授信对象限于符合各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、低风险业务、金融衍生品等本外币业务, 具有明确的用途, 授信额度、授信期限以银行最终核定为准, 本次申请银行授信额度将由公司和子公司根据实际业务需求, 在授信额度内以信用证使用, 同时, 公司拟于子公司授信总额不超过 14,000 万元人民币的银行授信额度, 拟用于支付信用证。

2. 高级管理人员、研发创新等
3. 研发投入
4. 研发投入
5. 研发投入
6. 研发投入
7. 研发投入
8. 研发投入
9. 研发投入
10. 研发投入

1. 公司简介
2. 主要业务
3. 服务网络
4. 主要经营模式
5. 主要客户
6. 主要供应商
7. 主要风险

1.1 行业分析
1.1.1 半导体封装材料行业
1.1.2 先进封装材料行业
1.1.3 导热材料行业
1.1.4 封装材料行业

1.2 行业分析
1.2.1 行业分析
1.2.2 行业分析
1.2.3 行业分析

1.3 行业分析
1.3.1 行业分析
1.3.2 行业分析
1.3.3 行业分析

1.4 行业分析
1.4.1 行业分析
1.4.2 行业分析
1.4.3 行业分析

1.5 行业分析
1.5.1 行业分析
1.5.2 行业分析
1.5.3 行业分析

1.6 行业分析
1.6.1 行业分析
1.6.2 行业分析
1.6.3 行业分析

1.7 行业分析
1.7.1 行业分析
1.7.2 行业分析
1.7.3 行业分析

1.8 行业分析
1.8.1 行业分析
1.8.2 行业分析
1.8.3 行业分析

1.9 行业分析
1.9.1 行业分析
1.9.2 行业分析
1.9.3 行业分析

1.10 行业分析
1.10.1 行业分析
1.10.2 行业分析
1.10.3 行业分析

1.11 行业分析
1.11.1 行业分析
1.11.2 行业分析
1.11.3 行业分析

1.12 行业分析
1.12.1 行业分析
1.12.2 行业分析
1.12.3 行业分析

1.13 行业分析
1.13.1 行业分析
1.13.2 行业分析
1.13.3 行业分析

1.14 行业分析
1.14.1 行业分析
1.14.2 行业分析
1.14.3 行业分析

1.15 行业分析
1.15.1 行业分析
1.15.2 行业分析
1.15.3 行业分析

1.16 行业分析
1.16.1 行业分析
1.16.2 行业分析
1.16.3 行业分析

1.17 行业分析
1.17.1 行业分析
1.17.2 行业分析
1.17.3 行业分析

1.18 行业分析
1.18.1 行业分析
1.18.2 行业分析
1.18.3 行业分析

1.19 行业分析
1.19.1 行业分析
1.19.2 行业分析
1.19.3 行业分析

1.20 行业分析
1.20.1 行业分析
1.20.2 行业分析
1.20.3 行业分析

1.21 行业分析
1.21.1 行业分析
1.21.2 行业分析
1.21.3 行业分析

1.22 行业分析
1.22.1 行业分析
1.22.2 行业分析
1.22.3 行业分析

1.23 行业分析
1.23.1 行业分析
1.23.2 行业分析
1.23.3 行业分析

1.24 行业分析
1.24.1 行业分析
1.24.2 行业分析
1.24.3 行业分析